



Laser marking

BSP



Lazer markalama ve gravürleme sistemi
Laser marking and engraving system

Esneklik : Flexibility

Proses bilgisi ve uygulama ihtiyaçları ile birlikte yapı özellikleri, BSP'yi basitlik ve üretkenlik açısından yenilikçi bir sistem haline getirir. 20 ila 100 W arasındaki güç aralığı, mevcut en yüksek standartlarla uyumlu gravür, markalama, yüzey işleme ve mikro kesme işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanır.

The knowledge of the process and of the application needs combined with the construction characteristics make BSP an innovative system for simplicity and productivity. The range of sources from 20 to 100W allows you to perform engraving, marking, surface processing and micro-cutting processes aligned with the highest standards available.

Kompakt sistem

BSP, ağırlığı 20 kg'a kadar olan parçalar için mükemmel proses stabilitesini garanti eden granit çalışma düzlemi sayesinde kompakt ve sağlam bir yapıya sahiptir. Taban yapısı, 50 µm hareket hassasiyetine sahip 3 motorlu eksen, 300 x 300 mm düzleminde strok ve Z eksenini boyunca 300 mm genlik içerir. Döner veya döner devirmeli mil, dinamik ölçüm ve görüntüleme sistemlerigibi bir dizi aksesuarla donatılabilir.

Compact system

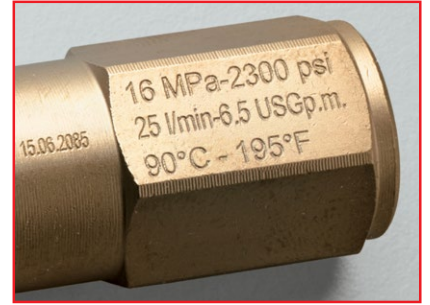
BSP has a compact and solid structure thanks to the granite working plane that guarantees excellent process stability for pieces up to 20 kg in weight. The base structure includes 3 motorized axes with 50 µm precision of movement, stroke on the plane of 300 x 300 mm and an amplitude along the Z axis of 300 mm. It can be equipped with a series of accessories like the rotating or rotary-tilting spindle, dynamic measuring and vision systems.

Gelişmiş yazılım

Tamamen SISMA tarafından geliştirilen entegre yazılım, karmaşık işlerde bile dosyaları ve tüm markalama sürecini yönetmek için ideal çözümdür: BSP PICO'nun tüm potansiyelinden tam olarak yararlanmanıza olanak tanır ve hızla göre yüksek düzeyde özelleştirmeyi garanti eder. Operatörün işini kolaylaştırın ve basitleştirin.

Advanced software

Entirely developed by SISMA, the integrated software is the ideal solution for managing files and the entire marking process, even in the case of complex jobs: allowing you to fully exploit all the potential of BSP PICO, it guarantees a high degree of customization to speed up and simplify the operator's work.



Teknik Veri - Technical Data

	200F EP	300F	500F	1000F
Aktif malzeme - Active material	Yb	Yb	Yb	Yb
Ort güç - Average power	20 W	30 W	50 W	100 W
Dalgaboyu - Wavelength	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm
Frekans - Frequency	1 ÷ 1000 kHz	1 ÷ 500 kHz	1 ÷ 1000 kHz	1 ÷ 4000 kHz
Darbe süresi - Pulse Duration	3 - 500 ns	26 - 250 ns	6 - 500 ns	4 - 2000 ns
Maks güç - Peak power	>10 kW	>10 kW	>10 kW	>10 kW
Darbe enerjisi - Pulse energy	>1 mJ	>1 mJ	>1 mJ	>1,2 mJ
Işın kalitesi - Beam quality (M ²)	<1,6	<1,6	<1,6	<1,6
Soğutma sistemi - Cooling system	Hava/Air	Hava/Air	Hava/Air	Hava/Air
Eksen hareketi (XYZ) - Axis stroke (XYZ)	300 mm x 300 mm x 300 mm			
Maks parça ağırlığı - Max piece weight	20 kg			
Hassasiyet - Precision	0,05 mm			
Tekrarlanabilirlik - Repeatability	0,02 mm			
Güç kaynağı - Power supply	230 V ± 15% 50/60 Hz - single phase - CEE 16A socket / presa			
Güç emilimi - Power absorption	1 kW			
Boyutlar (LxDxH) - Dimensions	823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 mm with open door - kapak açık)			
Ağırlık - Weight	590 kg			

Katalogda yer alan özellikler, görseller, performanslar, ağırlıklar ve ölçüler tamamen gösterge niteliğinde ve yaklaşık olup, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.